

2011年3月期 第1四半期決算概要

ルネサス エレクトロニクス株式会社

2010年7月29日

代表取締役社長 赤尾 泰

(本プレゼンテーションに関する注意)

本資料における前連結会計年度(2010年3月期)の業績数値は、旧NECエレクトロニクス(株)と旧(株)ルネサス テクノロジーの前連結会計年度の業績数値を単純合算したものであります。なお、「売上高」および「半導体売上高」については、旧NECエレクトロニクス(株)の表示方法と整合させるために旧(株)ルネサス テクノロジーについて一部組替表示しております。

(将来予測に関する注意)

本資料に記載されているルネサス エレクトロニクスグループの計画、戦略および業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づきルネサス エレクトロニクスグループが判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績等は、様々な要因により、これら見通し等とは大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承知願います。実際の業績等に影響を与える重要な要因としては、(1)ルネサス エレクトロニクスグループの事業領域を取り巻く日本、北米、アジア、欧州等の経済情勢、(2)市場におけるルネサス エレクトロニクスのグループ製品、サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、(3)激しい競争にさらされた市場においてルネサス エレクトロニクスグループが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを供給し続けていくことができる能力、(4)為替レート(特に米ドルと円との為替レート)の変動等がありますが、これら以外にも様々な要因がありえます。また、世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷等により、実際の業績等が当初の見通しと異なる結果となる可能性もあります。

エグゼクティブサマリー

I. 2011年3月期 第1四半期決算概要

- 統合ベースで、売上高は前四半期比較で100億円の増収達成。
営業益はほぼ均衡圏へ
- 当期純損益には、構造対策費用(固定資産減損等)を計上

II. 2011年3月期通期業績見通し

- 売上増加、構造対策等により、統合コストを吸収し、通期は営業黒字確保の見込み
- 当期純損益は、構造対策費用の計上により800億円の損失見込み

III. 100日プロジェクトの検討結果と実行プラン

IV. まとめ

2011年3月期 第1四半期決算概要

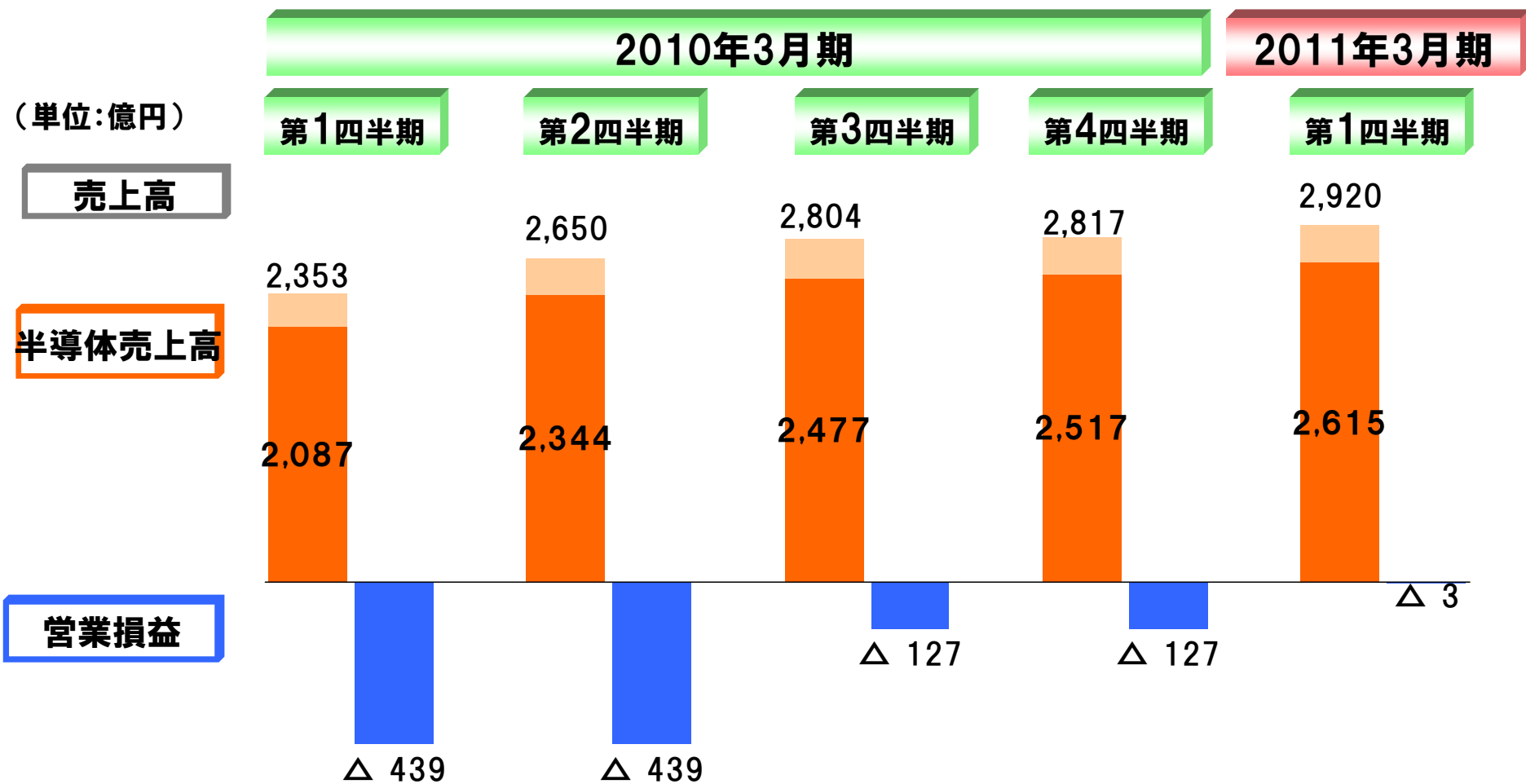
第1四半期(4-6月期)決算概要

- 第1四半期は、前四半期比売上増4%
- 営業損益は大幅改善、統合コストを除く実力ベースでは黒字浮上
- 当期純損益は、固定資産の減損などにより大幅損失

(単位：億円)	2010年3月期		2011年3月期		
	第1四半期	第4四半期	第1四半期	前年同期比	前四半期比
	売上高	2,353	2,817	2,920	+567
半導体売上高	2,087	2,517	2,615	+527	+98
営業損益	△439	△127	△3	+436	+123
経常損益	△450	△162	△35	+415	+127
当期純損益	△445	△176	△331	+114	△155
1US\$=	-	-	92円	-	-
1ユーロ=	-	-	121円	-	-

四半期別業績推移

■ 第1四半期は、売上高、営業損益ともに改善



第1四半期半導体売上高(前年同期比、前四半期比)

- 第4四半期から4%増収
- マイコンは、中国市場を中心とする新興国で増収

2011年3月期

(単位:億円)

第1四半期 前年同期比(%) 前四半期比(%)

	第1四半期	前年同期比(%)	前四半期比(%)
半導体売上高	2,615	+25%	+4%
SoC	777	△3%	△4%
マイコン	993	+42%	+6%
アナログ&パワー半導体	826	+45%	+9%
その他半導体	18	△17%	+101%

事業別売上概況(前四半期比)

SoC

【↓】: PC周辺、民生機器分野を中心に減収

マイコン

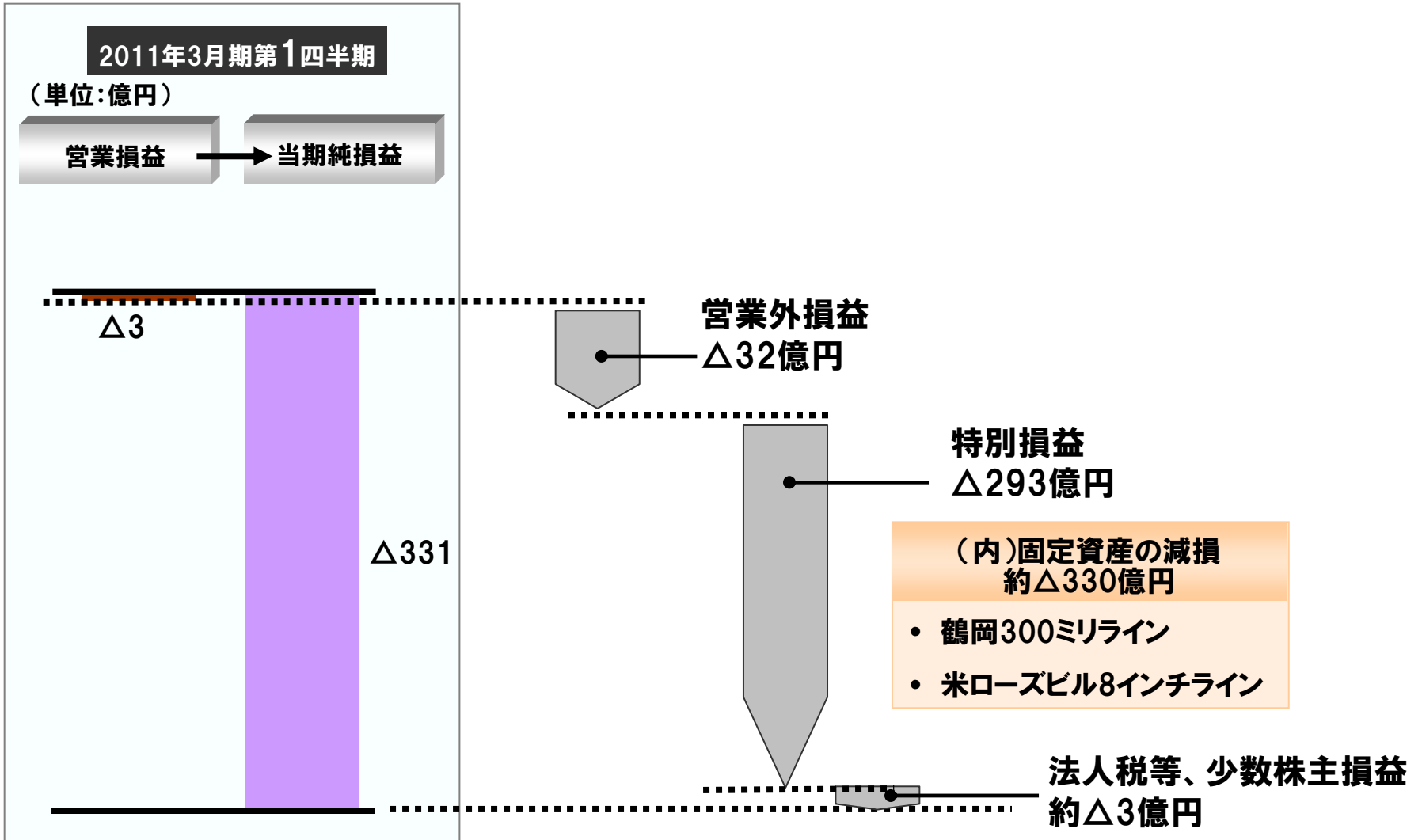
【↑】: 自動車向け、汎用ともに増収

アナログ&パワー半導体

【↑】: 全般的に増収

第1四半期 当期純損益概況(営業損益からの推移)

- 営業損益は前四半期比大幅改善したものの、固定資産の減損を計上したことにより、第1四半期の当期純損益は大幅な損失。



バランスシート

(単位:億円)

	10/4期首 (増資後)	10/6末
総資産	12,154	11,510
うち 現金及び現金同等物	3,377	3,186
うち たな卸資産	1,266	1,307
負債合計	8,017	7,775
うち 有利子負債	3,720	3,754
株主資本	4,210	3,880
純資産合計	4,136	3,735
D/Eレシオ(グロス)	0.91倍	1.02倍
D/Eレシオ(Net)	0.08倍	0.15倍
自己資本比率	33.5%	31.9%

(注1)①現金及び現金同等物:「現金及び預金」と「有価証券」の単純合算値から「預入期間が3か月を超える定期預金」を控除しております。

②有利子負債:「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「1年内償還予定の新株予約権付社債」、「リース債務」、「新株予約権付社債」、「長期借入金」

③自己資本:「株主資本」、「評価・換算差額等」

④D/Eレシオ(グロス):有利子負債/自己資本

⑤10/4期首(増資後)の負債合計には、負ののれん22億円を便宜的に含めております。

(注2)「10/4期首(増資後)」の数値は、当連結会計年度期首の数値に2010年4月1日付の企業結合に係る会計処理および同日付の第三者割当増資約1,346億円を反映した数値です。

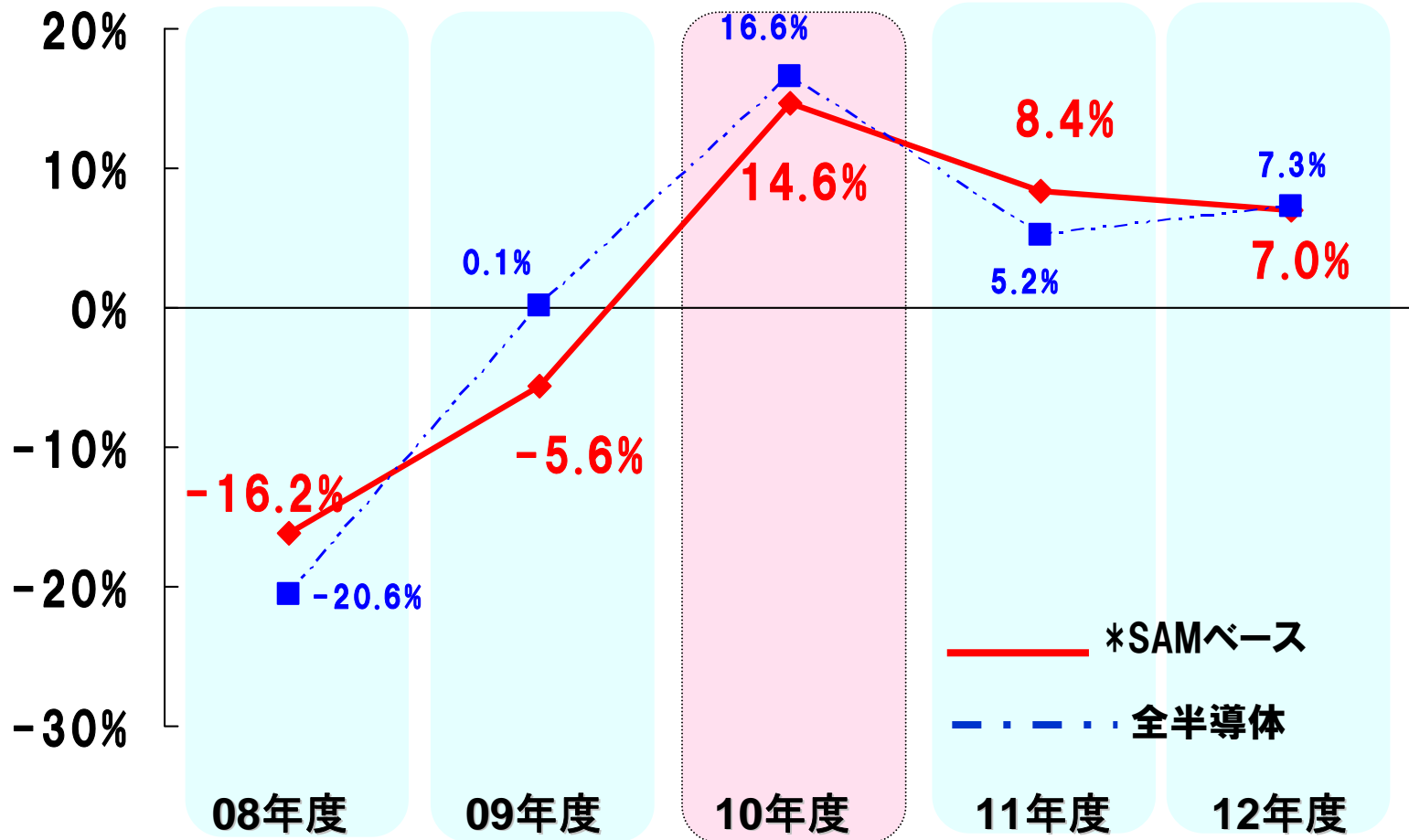
キャッシュ・フロー

(単位：億円)	2010年3月期			2011年3月期
	第1四半期	第4四半期	年度計	第1四半期
営業活動による キャッシュ・フロー	△406	168	246	△20
投資活動による キャッシュ・フロー	△240	△212	△768	△144
フリー・ キャッシュ・フロー	△647	△43	△523	△164

2011年3月期 通期業績見通し

半導体市場動向

半導体市場(対前年伸び率)推移(円ベース)



*SAM:全半導体からDRAM, MPU, Flash, Sensorを除いた市場
出典:WSTS,ルネサスエレクトロニクス

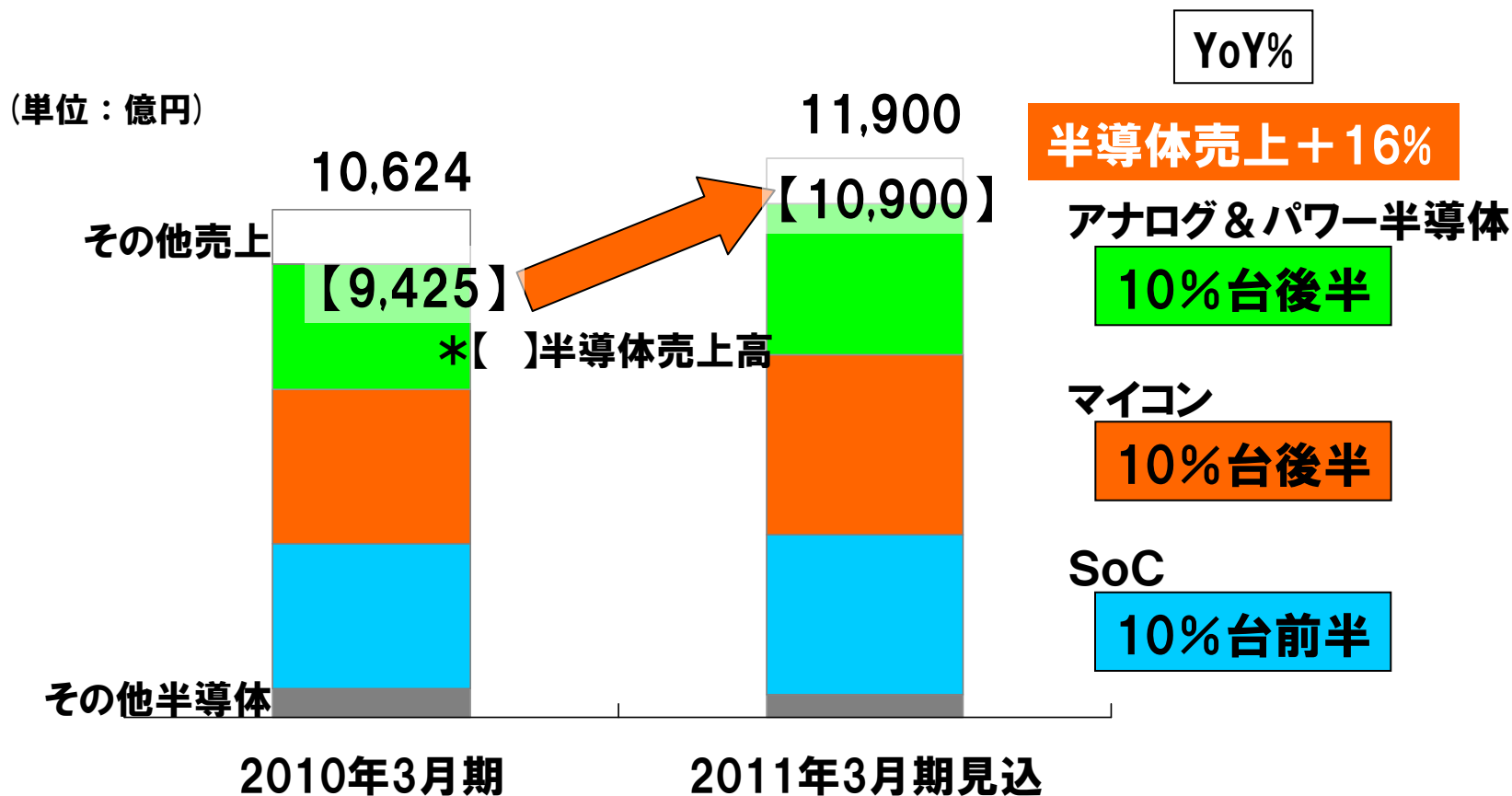
2011年3月期 通期業績見通し

- 通期営業黒字化を見込む。
- 当期純損益については100日プロジェクトにおける構造対策推進等による特別損失770億円の計上を見込み、大幅赤字の見通し

	2010年3月期			2011年3月期見通し			
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	前年比
(単位：億円)							
売上高	5,003	5,621	10,624	5,900	6,000	11,900	+1,276
半導体売上高	4,431	4,994	9,425	5,400	5,500	10,900	+1,475
営業損益	△879	△254	△1,133	△20	90	70	+1,202
経常損益	△934	△320	△1,253	△80	30	△50	+1,203
当期純損益	△992	△385	△1,378	△420	△380	△800	+577
1US\$=				90円			
1ユーロ=				110円			

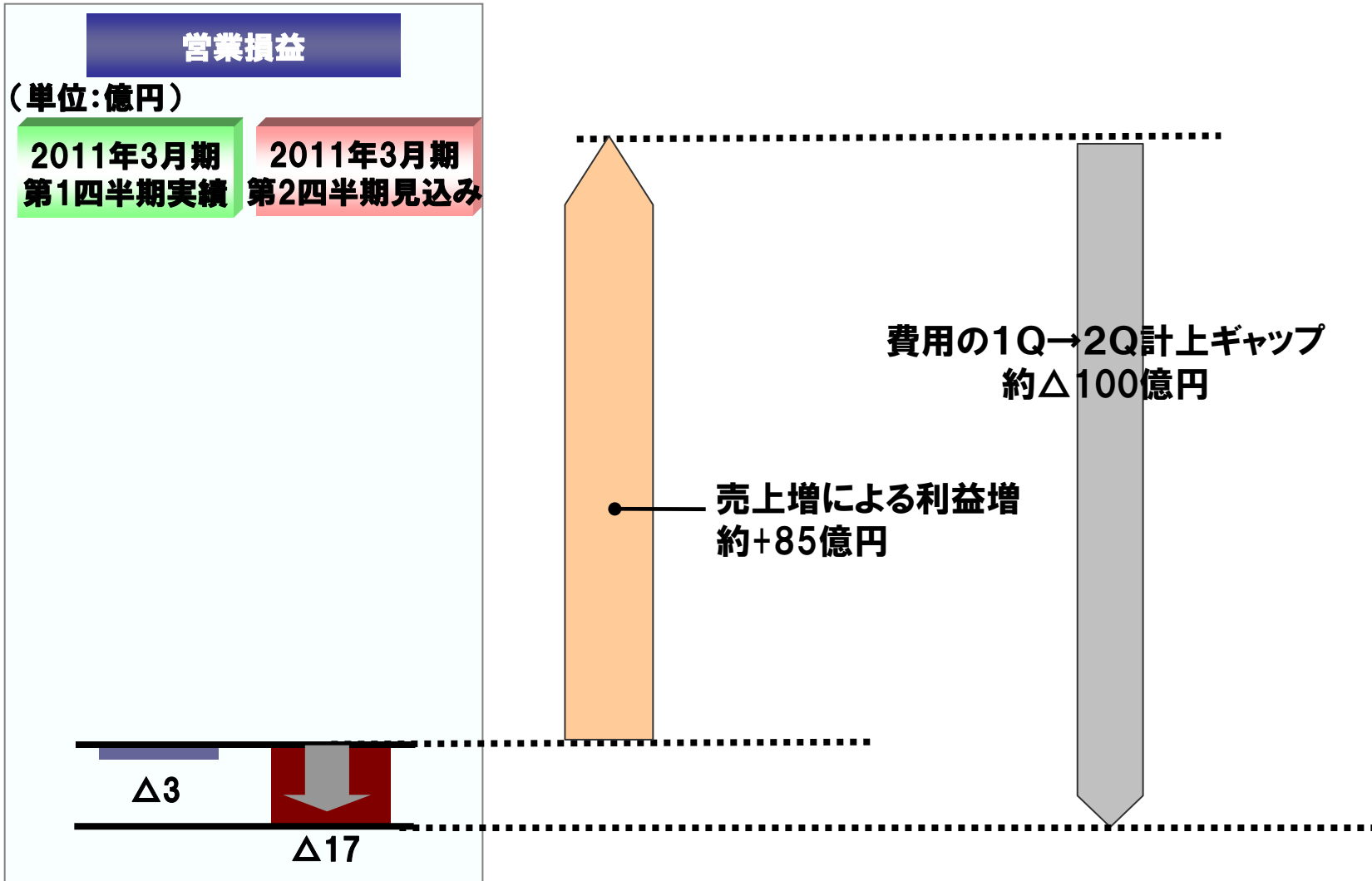
2011年3月期売上高見通し

- 製品ポートフォリオの再構築によるディスシナジー効果を吸収して、市場以上の成長を達成する見込み
- 足元の好調さを反映し、5月時点から売上高見通しを200億円上方修正
- 海外市場向け売上高の拡大



2011年3月期 第2四半期営業損益見込み

- 売上増による利益増が見込まれるものの、費用が通常期末に集中することにより、営業赤字を見込む



2011年3月期上/下期 営業損益見込み

■ 統合シナジーによる固定費削減効果などにより
 売上改善(約100億円増)以上の利益改善となる
 見込み

営業損益

(単位:億円)

2011年3月期
 上期見込み

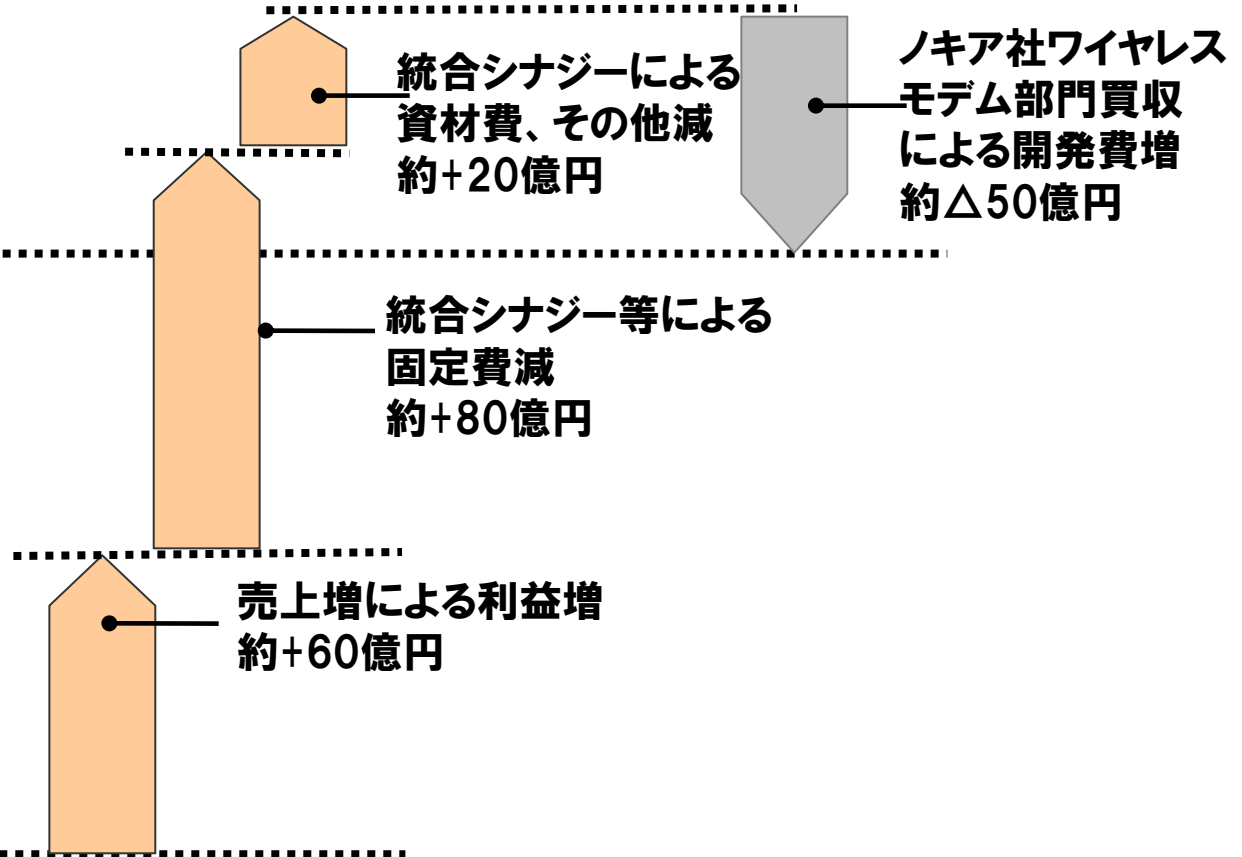
2011年3月期
 下期見込み

統合初期費用(下期)
 約30億円

90

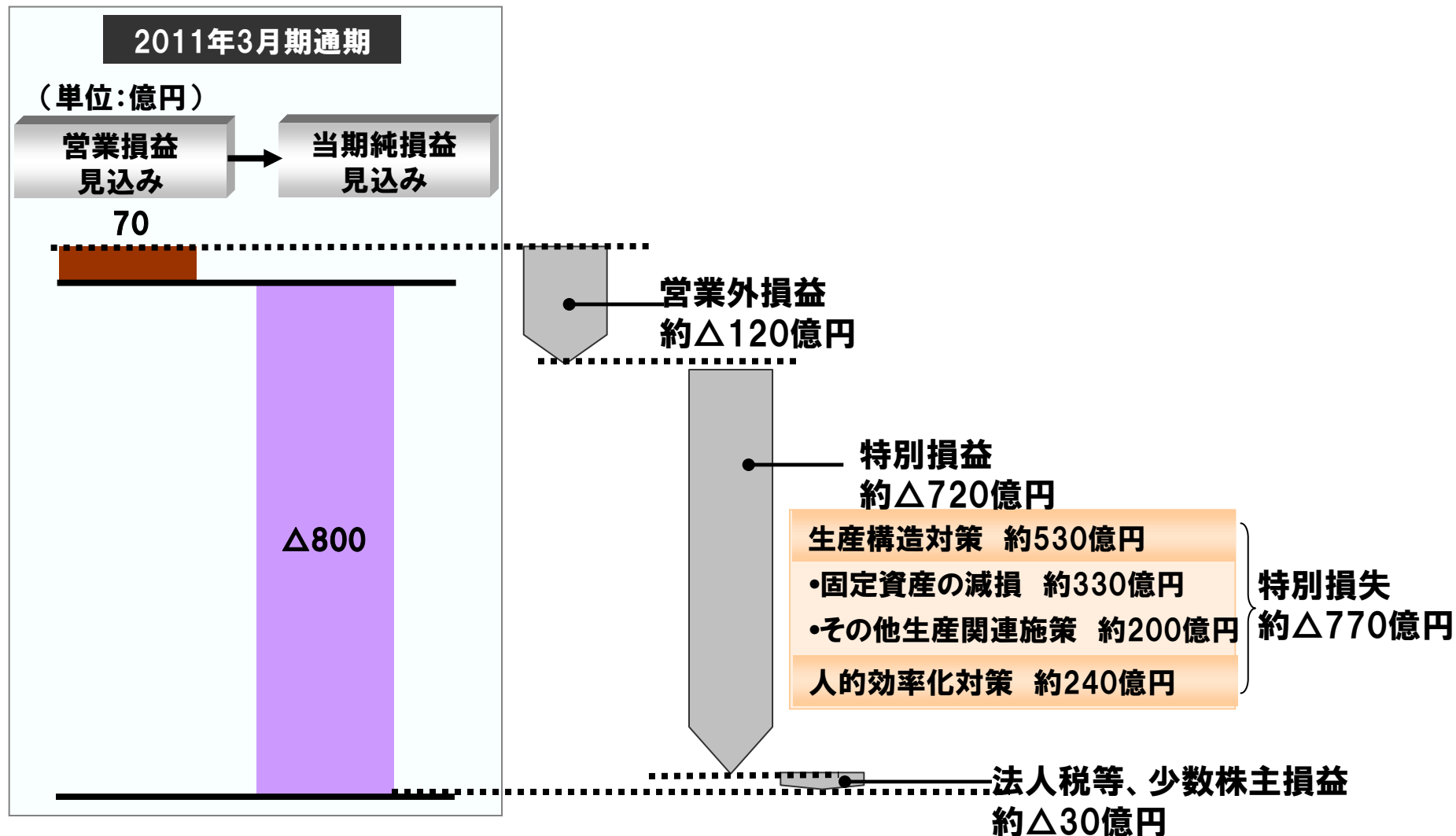
統合初期費(上期)
 約30億円

△20



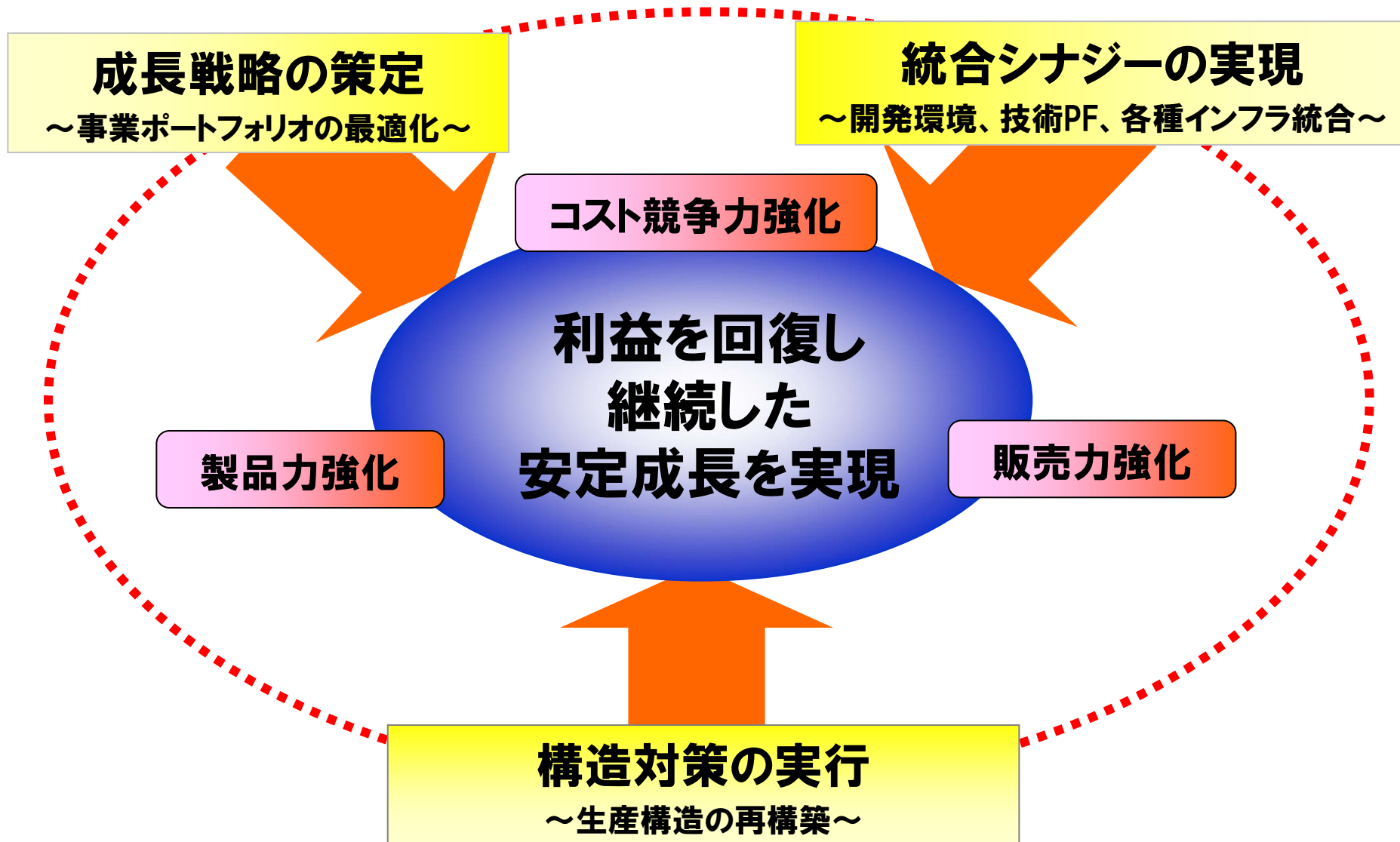
2011年3月期 当期純損益見込み(営業損益からの推移)

- 統合初年度に抜本的な構造対策を決定・実行し、通期で約770億円の特別損失を計画



III. 100日プロジェクトの検討結果と実行プラン

「100日プロジェクト」の概要



「100日プロジェクト」の効果のまとめ

目標

成長戦略の策定

12年度までの売上成長率：
10年度から7%～10%年平均成長

統合シナジーの実現

10年度～12年度累計
約400億円のシナジー効果創出

構造対策の実行

10年度～12年度累計
約700億円の費用抑制効果

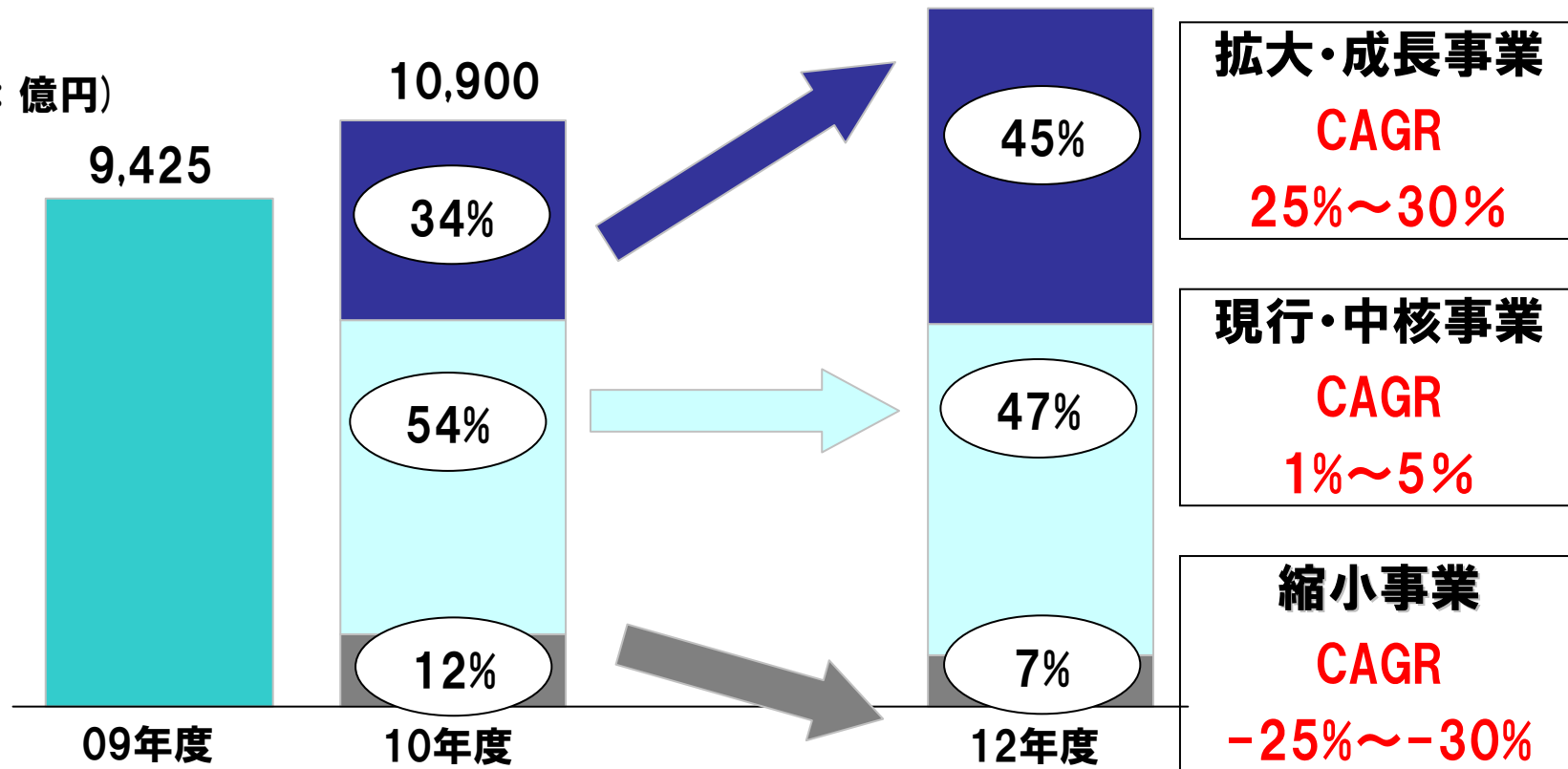
半導体売上計画

- 事業ポートフォリオの最適化により拡大・成長事業にリソースを集中
- 拡大・成長事業を柱に12年度に10年度比年平均7~10%成長を実現
- 現行・中核事業は効率化をはかりコスト競争力を強化

売上構成比

CAGR 7~10% (10⇒12年度)

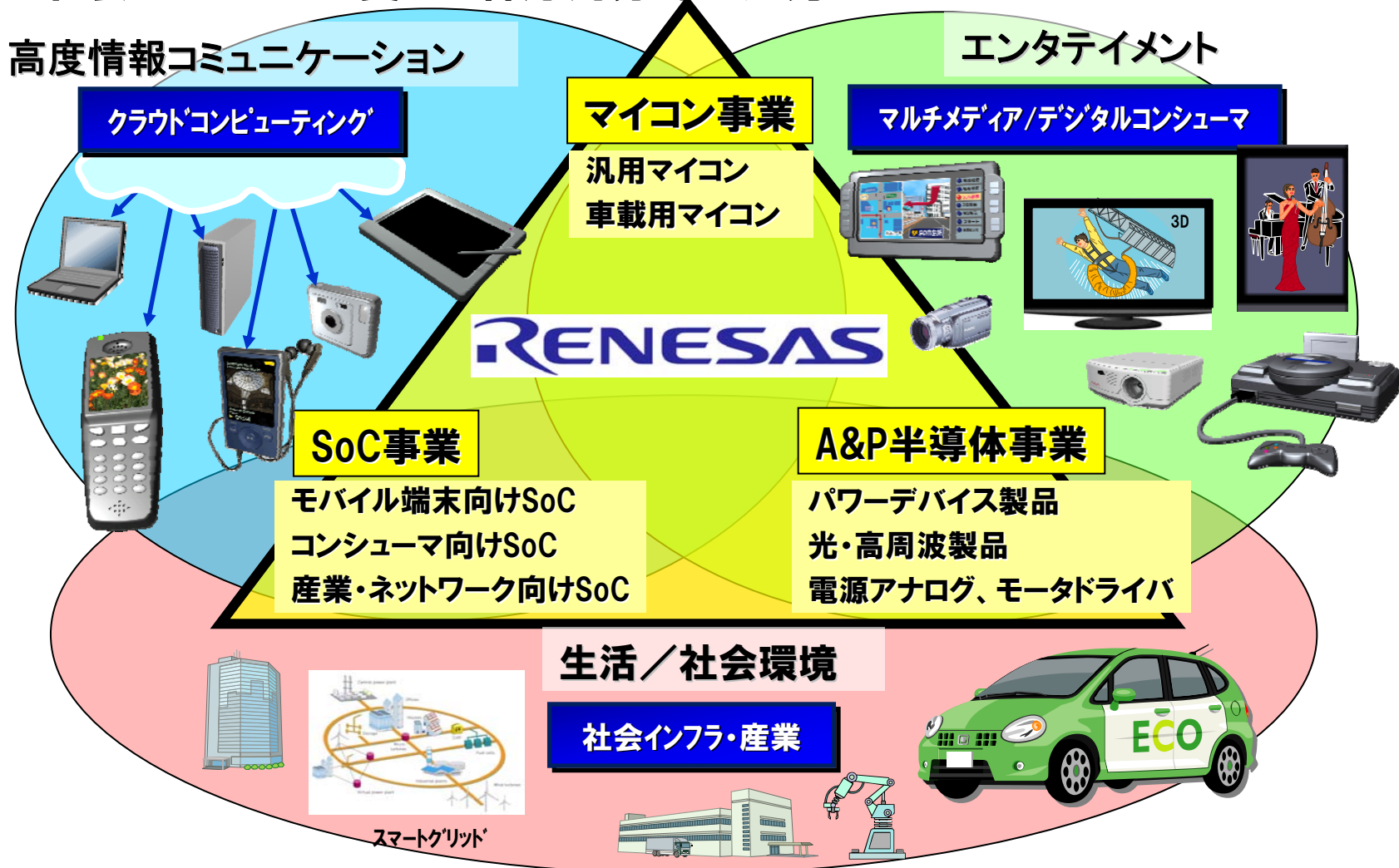
(単位：億円)



CAGR:年平均成長率

成長戦略の策定：当社の注力する事業領域

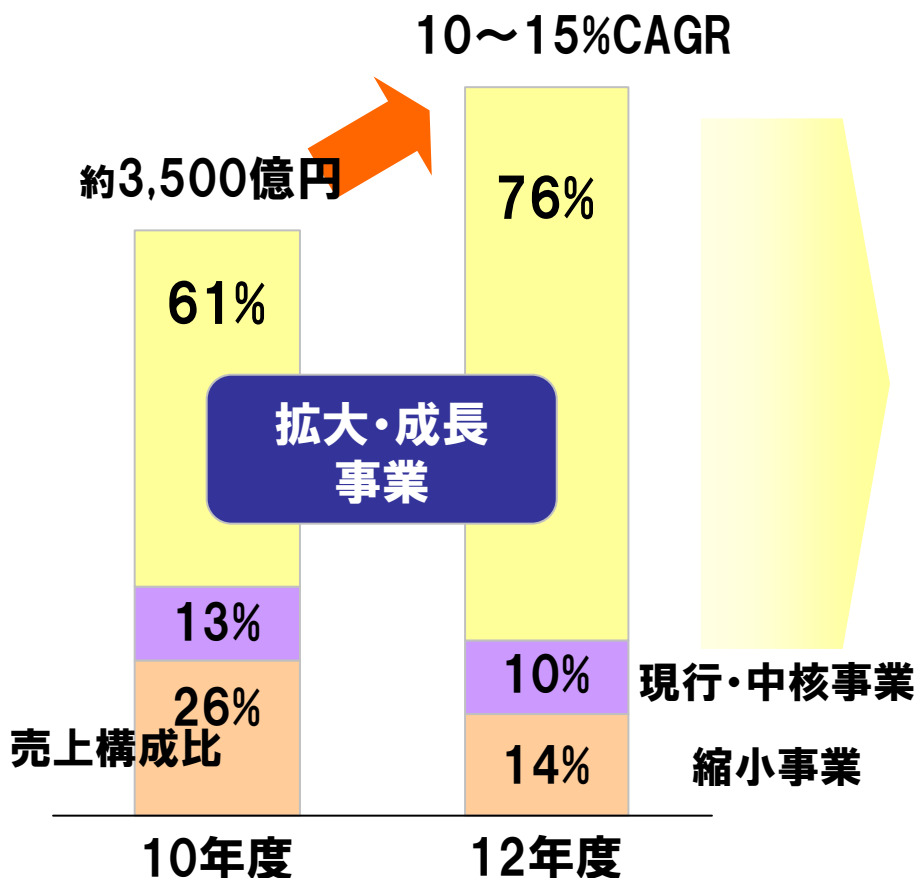
- 統合による事業の強みを活かし、これからの豊かな社会作りに貢献するため、生活／社会環境、エンターテイメント、高度情報コミュニケーションといった社会のインフラを支える各応用分野に注力



成長戦略の策定:SoC事業

- 様々な分野にまたがって拡大成長が見込まれ且つ総合力を有する当社の強みを発揮できる“インフラ”事業に集中

拡大・成長事業の方向性



通信インフラ	先端モデム技術(LTE)強化による事業拡大
マルチメディアインフラ	統合プラットフォーム構築 コスト競争力強化 -DTV、STB、CIS等 Si技術の優位性分野に特化 -エンタテインメント(ゲーム) USB3.0 W/W No.1堅持
産業インフラ	ネットワーク用メモリ強化 産業用ASIC強化 スマートグリッド分野強化

CAGR:年平均成長率

成長戦略の策定:SoC事業 通信インフラ強化(1)

～ノキア社の通信モデム部門買収

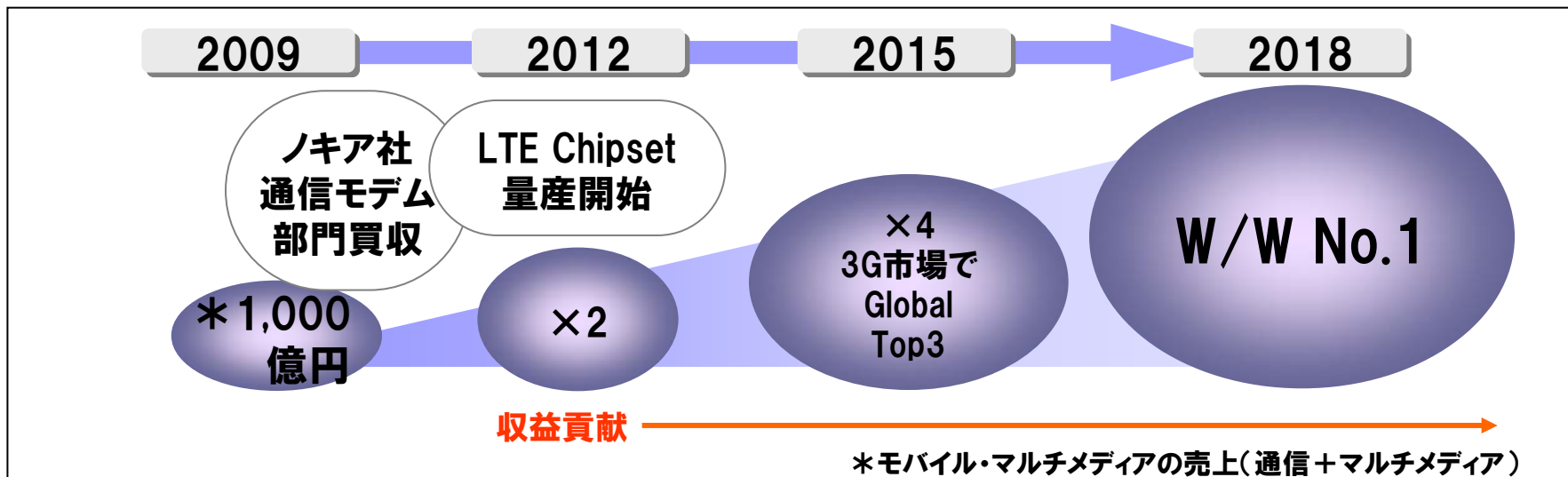
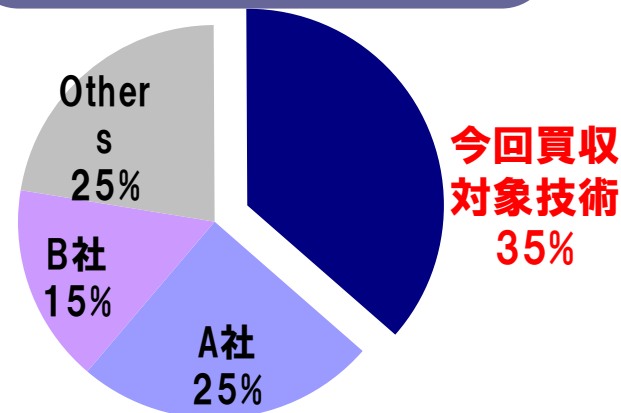
■ 買収技術のメリット

- >長期の蓄積が必要な特殊なIP
- >W/W No.1 シェア
- >過去数十億台に渡る採用実績
- >200社以上のオペレータとの接続検証済み

■ 通信インフラ事業の目標

- >世界トップのモバイルプラットフォームベンダーを目指す

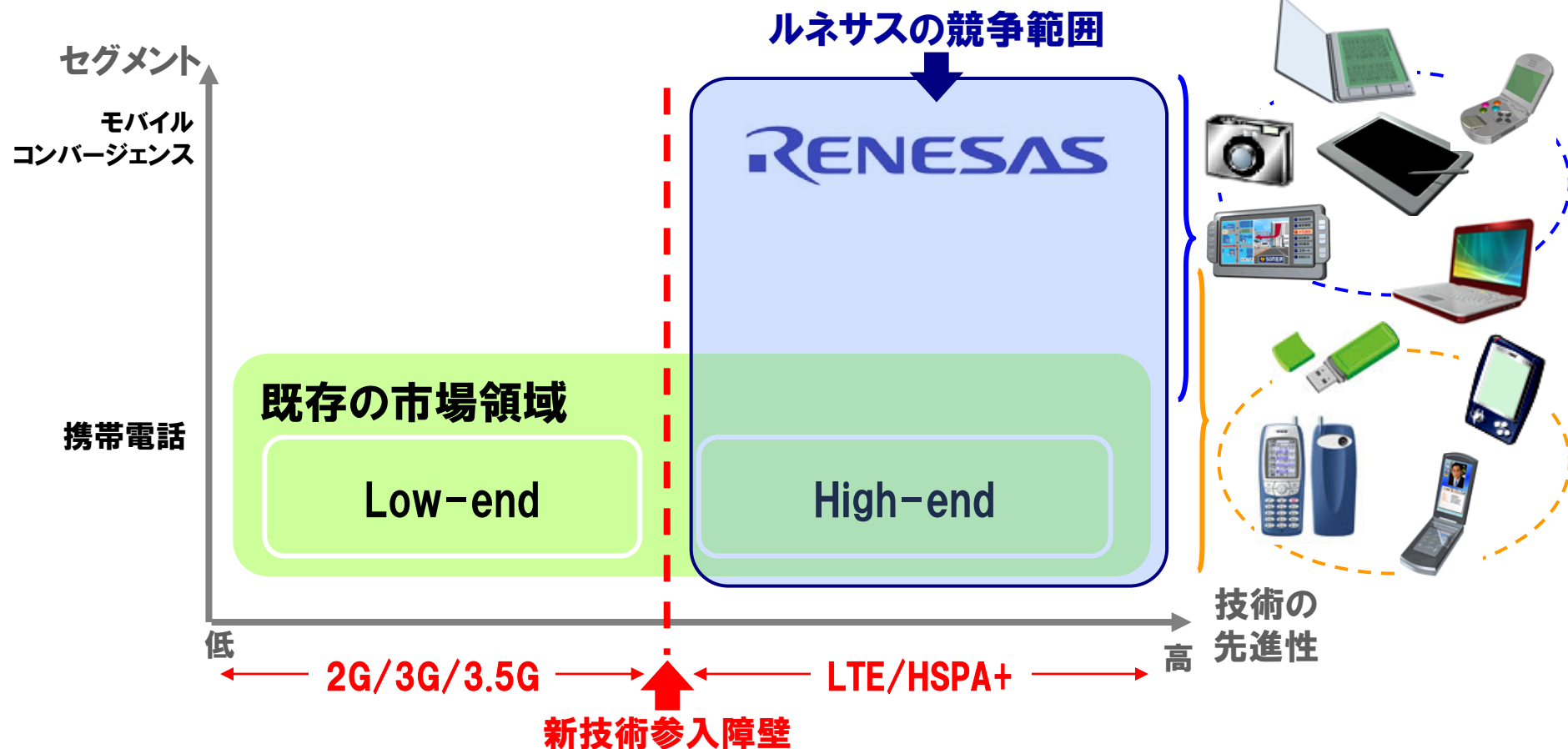
W/W 3Gモデム技術シェア



成長戦略の策定: SoC事業 通信インフラ強化(2)

～当社の強み

- >ネットワーク市場: 幅広いマイコン顧客との関係
 - ⇒モバイルコンバージェンス市場に競合との優位性あり
- >モデム技術獲得により、プラットフォーム開発力・サポート力強化

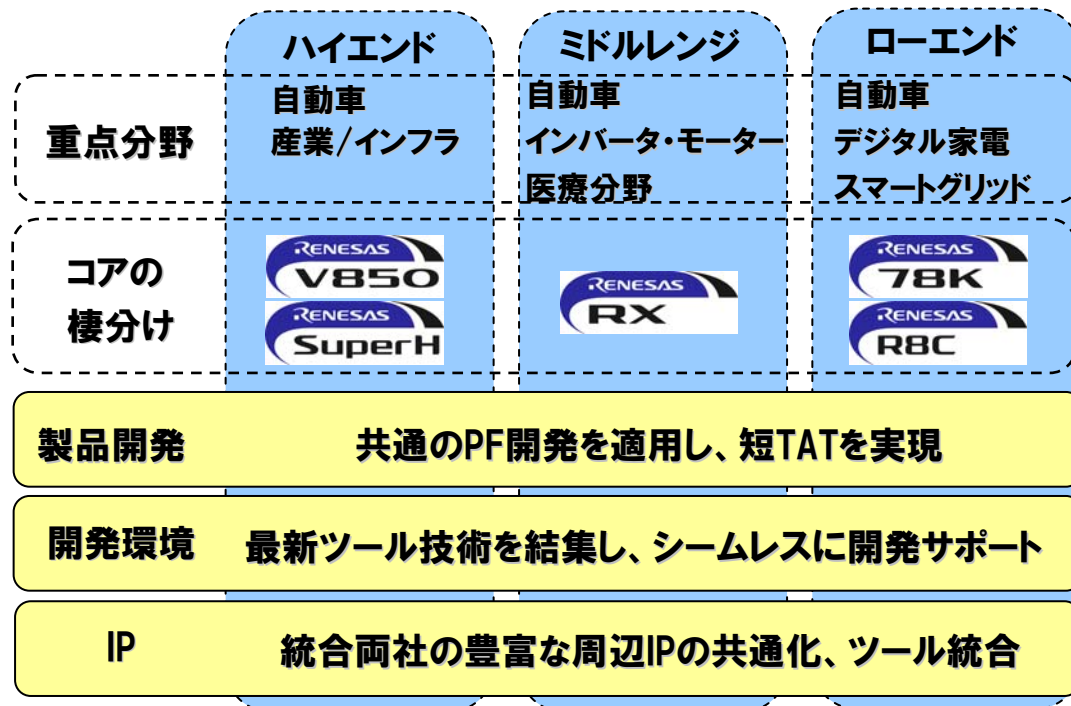
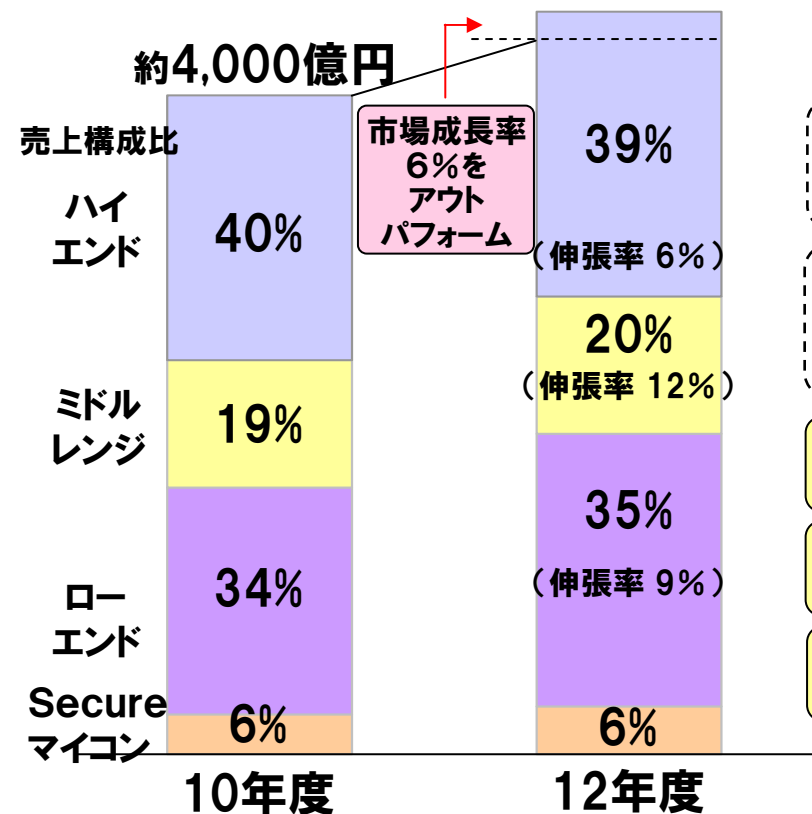


成長戦略の策定:マイコン事業 安定成長の実現

- 旧NECエレクトロニクスと旧ルネサステクノロジの強みを結集し、市場成長率を上回る伸びで、安定成長の実現を目指す
- 統合によって生み出した経営資源により、新市場(中国)、重点市場への取組みを強化
- 次世代統合プラットフォーム環境を構築し、短TAT、豊富なIPを武器にダントツW/WNO.1シェアを確立

8~10% CAGR

マイコン重点分野及びコアの棲分け



CAGR: 年平均成長率

成長戦略の策定:マイコン事業 中国事業戦略

- 市場環境変化に即応し、現地で意思決定する体制によりビジネス成果の最大化をはかる

【中国市場環境の変化】

- 政府主導 ⇒ 社会インフラの拡充 ・ 省エネの推進
- 所得水準の向上 ⇒ 急速な車の普及 ・ 住居環境の改善

【市場環境の変化に即応できる体制の強化を推進】

- 現地ローカルTOPで10月1日から発足
- 上海に拠点設置、マーケティングから販売まで:約150名体制
- 中国の設計力を強化:現在600名 ⇒ 順次拡大、3年間で1,000製品を市場に投入

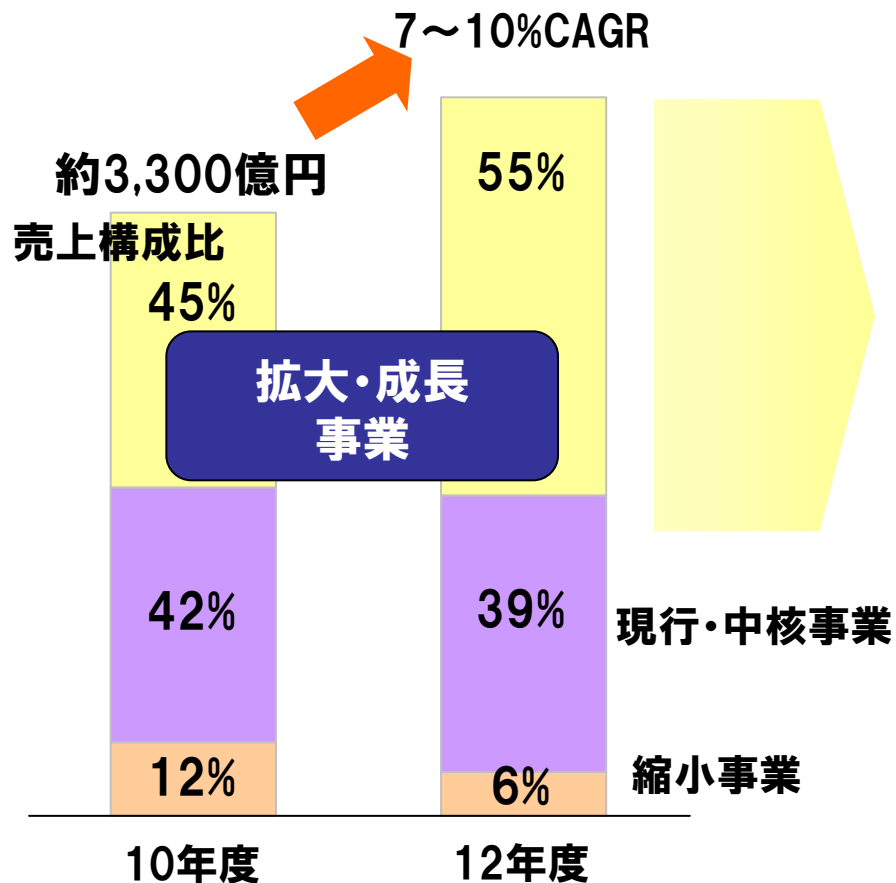
【市場環境の変化に対応したターゲットセグメントの決定】

~2012年度投入
予定製品数

<p>社会インフラの充実 実績NO.1</p> <p>電力メータ(スマートグリッドの地域展開加速) 水道、ガスメータ</p> <p style="text-align:right">100</p>	<p>急速な自動車の普及 実績NO.1</p> <p>ボディ、ダッシュボード、e-Bike</p> <p style="text-align:right">100</p>
<p>省エネの推進 実績NO.1</p> <p>インバータ家電(エアコン・冷蔵庫・洗濯機)、 LED照明</p> <p style="text-align:right">600</p>	<p>住居環境の改善 実績NO.1</p> <p>ホームセキュリティ他</p> <p style="text-align:right">200</p>

成長戦略の策定:A&P半導体事業

- 市場規模が大きく、かつ今後も拡大が見込める電源分野、自動車分野に注力
- アナログIC、パワーデバイス、光デバイスのキットソリューションを構築、ラインアップ強化
- マイコンの商流を活かしたソリューション提供により事業拡大を目指す（特に中国・新興国市場）



拡大・成長事業の方向性

電源分野	<ul style="list-style-type: none"> ・製品ラインアップ強化 ・マイコンとのキットソリューションを展開 ・中国、新興国市場で売上拡大
自動車分野	<ul style="list-style-type: none"> ・パワーMOSFET、IGBT等に加えパワーIC(IPD)のラインアップも強化 ・マイコン商流を活かして、海外市場を開拓

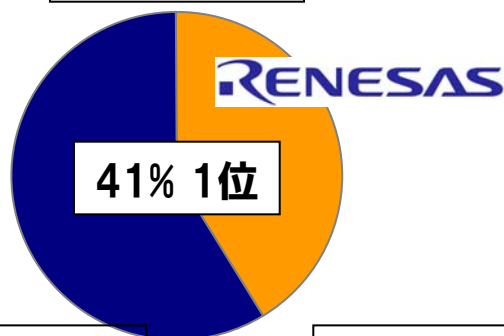
CAGR:年平均成長率

成長戦略の策定:マイコン事業とA&P半導体事業のシナジー

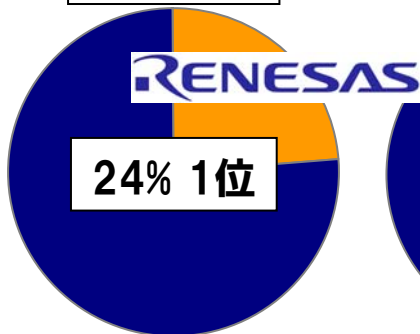
- マイコン事業で培ったシステム力や顧客ウインドウを背景に、ラインアップ強化でアナログ・パワーデバイス事業を強化

マイコン分野別シェア(09年)

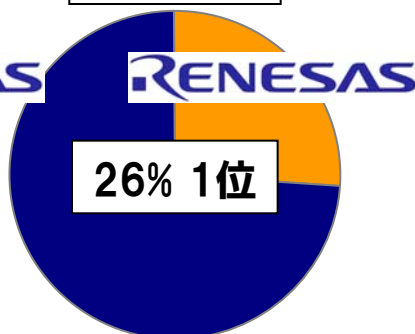
自動車分野



民生分野



産業分野



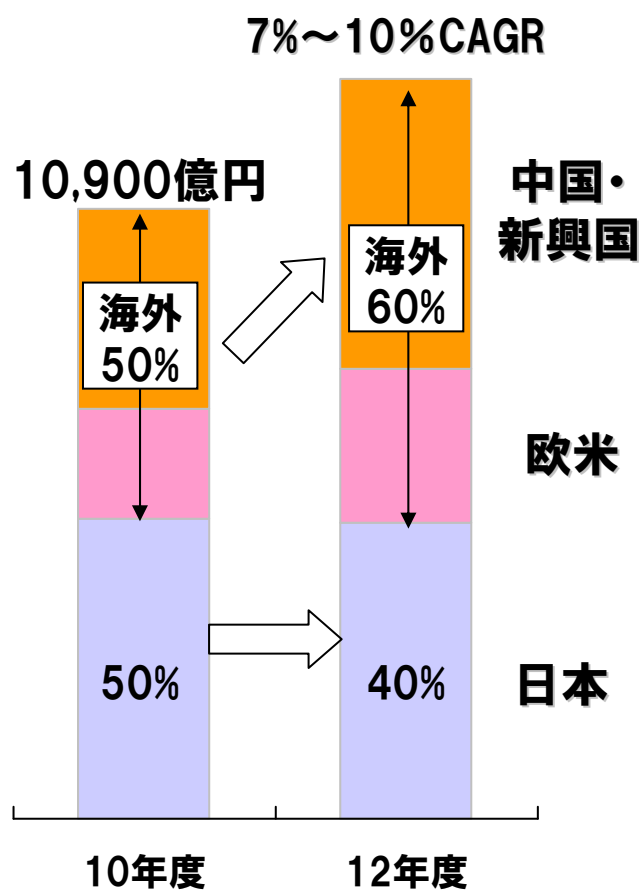
マイコンとA&P半導体キットソリューションの応用事例

分野	製品	キットソリューション応用事例
民生	家電・エアコン	IGBT+フォトカプラ+PFC-IC+マイコン
産業	産業インバータ応用(モータ)	IGBT+フォトカプラ+マイコン
自動車	自動車(HEV/EV)	IGBT+フォトカプラ+マイコン
産業	電池	パワーMOS+電池制御IC
産業	電力メータ	三端子レギュレータ+EEPROM+フォトカプラ+マイコン
民生	LED照明	パワーMOS+LEDドライバ+マイコン

注)各種調査に基づき、旧NECエレクトロニクスと旧ルネサステクノロジーのシェアを合算

成長戦略の策定：海外事業強化まとめ

- 12年度を目処に海外売上比率60%超へ
- 中国向けマイコン事業強化及びマイコンとアナログ & パワー半導体とのキットソリューションによる海外売上の拡大
- 通信インフラ事業の強化による海外売上の拡大



主な海外事業拡大施策

事業部門	主な拡大施策	重点地域
SoC	・次世代高速通信インフラ事業の拡大	欧米 中国・新興国
マイコン	・中国市場向け組織体制を強化(10月1日発足予定) ・ターゲットセグメントの決定 ・3年間で1000製品市場投入	中国・新興国
A&P半導体	・マイコンとのキットソリューション展開に向けたラインアップ強化	中国・新興国

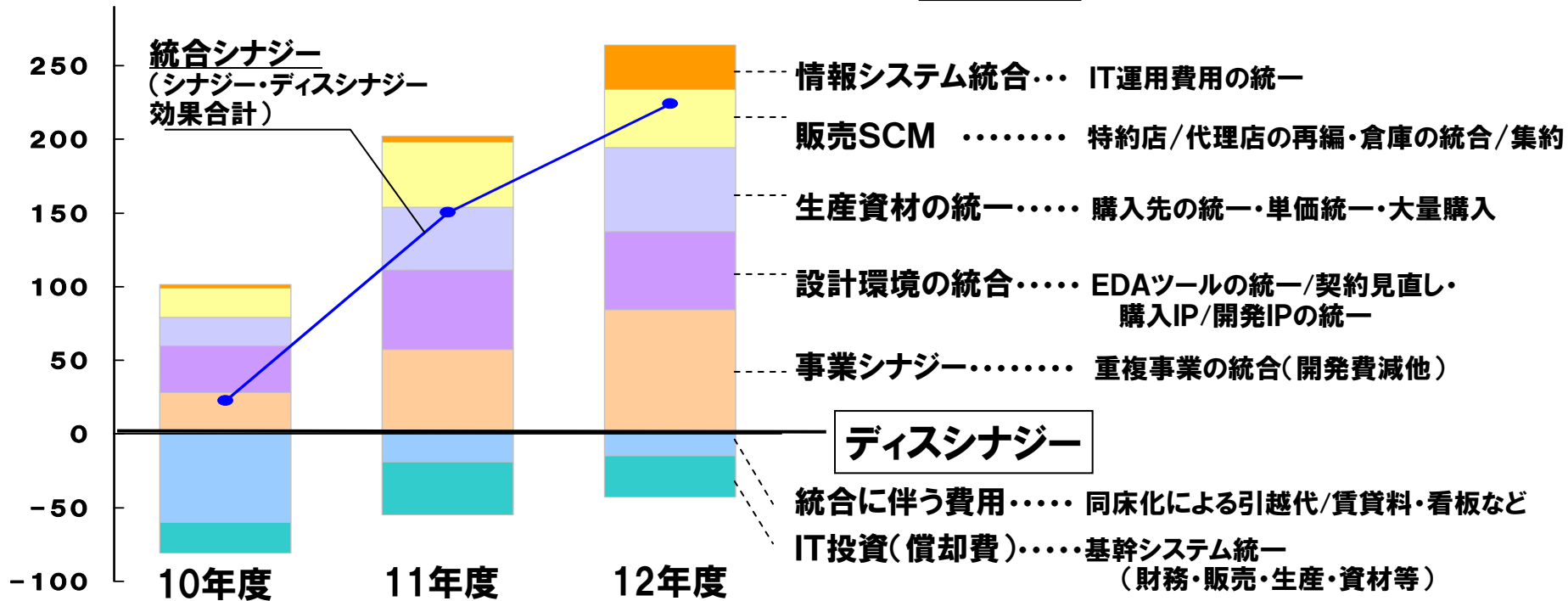
CAGR:年平均成長率

統合シナジーの実現：費用効果

■ 費用抑制の効果

10～12年度累計 約400億円費用抑制

(単位：億円)



■ 投資抑制の効果

生産性改善による売上げ時の投資抑制

…生産技術の融合/標準化・生産系SCM統合・材料認定業務簡素化

10～12年度累計 約120億円抑制

統合シナジーの実現:国内特約店半減を含む販売チャネルの最適化

- 販売チャネルの再構築によるフロント販売力の強化
- 販売効率向上による販売経費の改善

狙い

- 力のある特約店、代理店を中心に販売チャネルの再編
- 1チャネルの規模増・集中化による販売力の強化
- 販売経費の削減
- 物流コストの削減

施策

- 特約店・代理店の再編
- 特約店との取引条件見直し
- 営業人員の効率化
- WW倉庫の統合、輸送費の見直し、包装材運用の統合

構造対策の実行

- 市況変動に耐性があり、営業利益率2桁を実現する安定的成長を目指した根本的費用構造対策の推進

100日プロジェクト

人員効率化
約5千人規模の

事業・生産構造対策 約530億円

- ・ ファブ施策
- ・ 鶴岡工場及び米ローズビル工場の減損

人的効率化対策 約240億円

特別損失10年度計上 約770億円

統合シナジー効果

- ・ 情報システム統合
- ・ 販売SCM
- ・ 生産資材の統一
- ・ 設計環境の統合
- ・ 事業シナジー

構造対策の実行と
統合シナジーの実現により

10-12年度累計
約1,100億円の費用抑制

10年度約100億円

11年度約400億円

12年度約600億円

構造対策の実行: ファブ施策

- 自社生産能力前工程は、大規模な増産投資を抑制し、生産効率化を推進
- 自社生産能力後工程は、海外での能力増強を推進

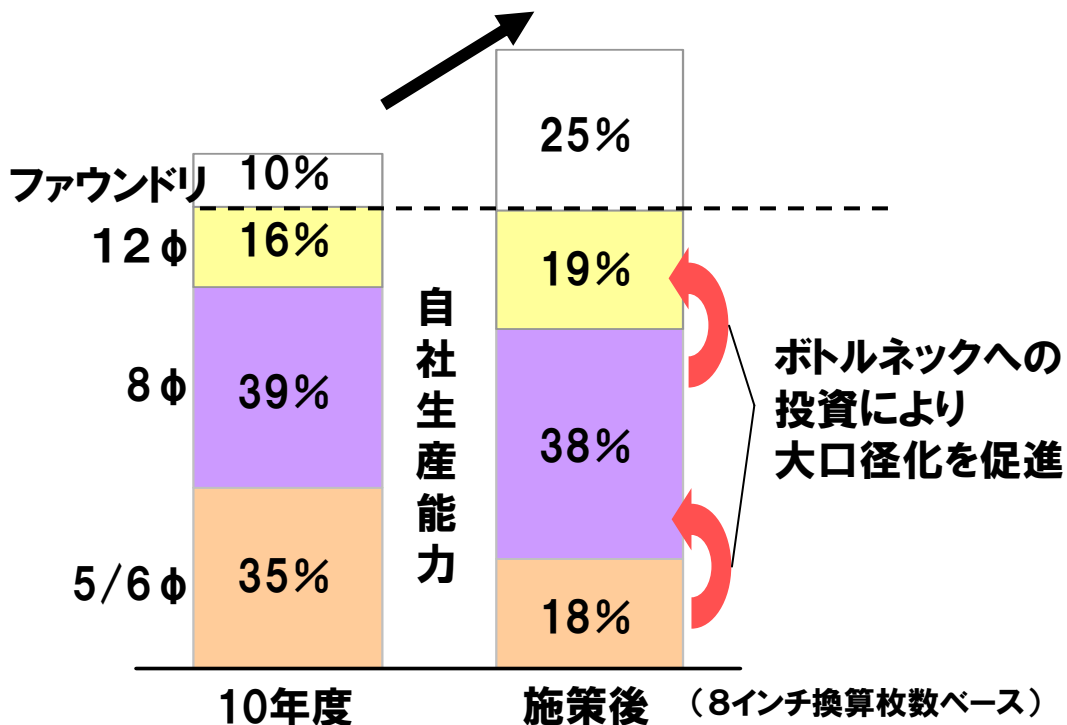
前工程

- ✓ 大口径化・微細化で生産効率向上
- ✓ 生産上振れ分は、先端を中心とした外ファブの活用を拡大
- ✓ 外ファブを含めたファブネットワークを構築し、製品の相互生産による稼働損リスクを軽減

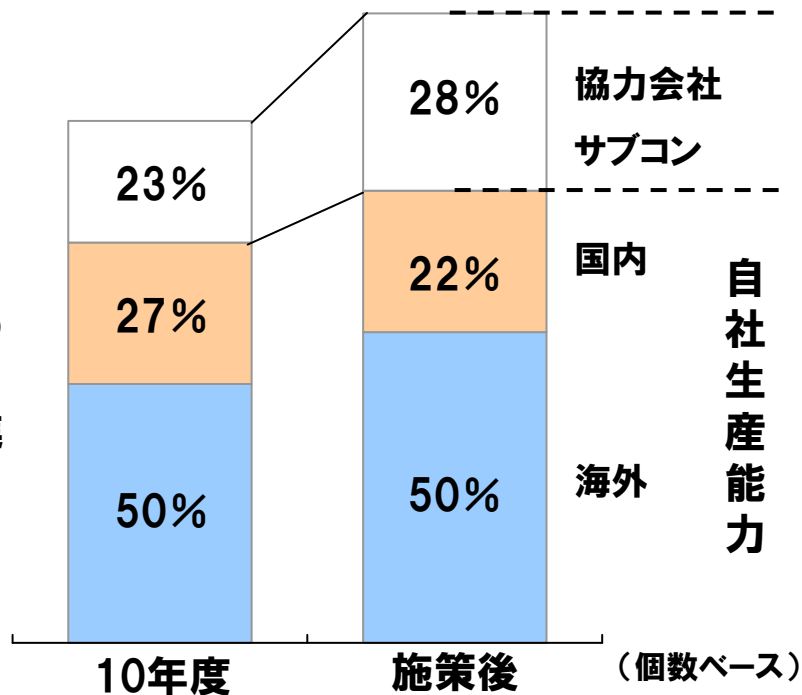
後工程

- ✓ 自社生産能力は、海外での能力増強を推進
- ✓ サブコンとのファブネットワークの構築
- ✓ 協力会社・サブコンの効率化

前工程生産計画



後工程生産計画



構造対策の実行:先端プロセス事業の今後の方針

28ナノ以降の先端プロセス製品の量産は外部ファブ(ファウンドリ)に全面的に委託

戦略パートナー

ルネサスエレクトロニクス(株)

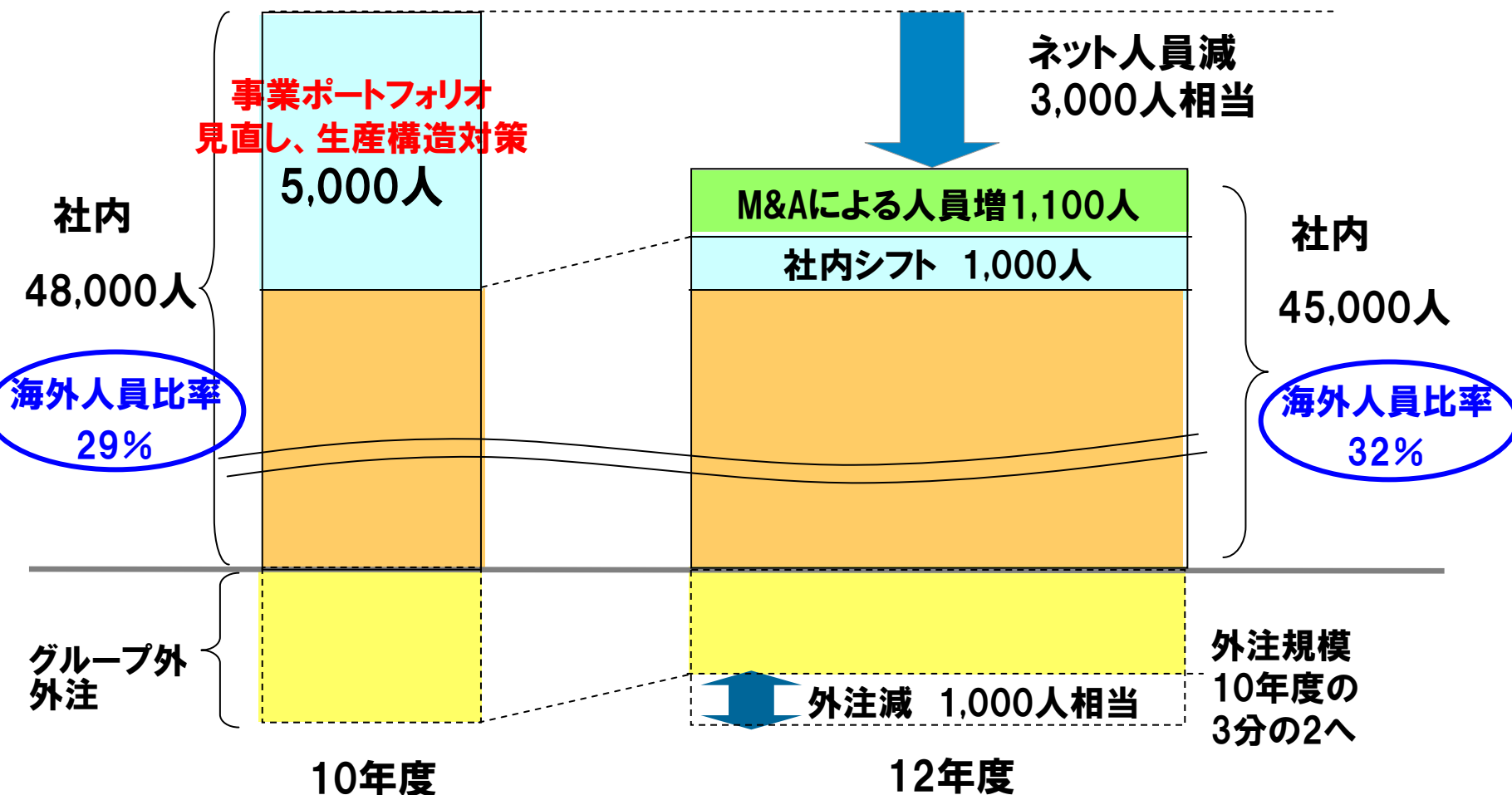
TSMC

グローバルファウンドリーズ

- 鶴岡、那珂の300mmラインは、40nmまでのSoC製品と、今後微細化が進むマイコンの量産にフル活用
- 先端プロセスのR&Dは一本化して継続。
- 次世代以降を見通すプロセス要素技術についてはIBMとの共同研究を維持。

構造対策の実行:人的効率化対策

- 約5,000人規模の人的効率化対策を主に10年度に、更に12年度にかけて実施予定
- グループ外の外注含めたトータル人的リソースを10%削減



IV. まとめ

経営目標

- **統合初年度より営業黒字を目指す**
- **必要な構造対策を統合の初期段階に集中して取り組み、2年目には当期黒字を目指す**
- **12年度までに磐石な経営基盤を構築し、中期的な営業利益率(売上高比)は2桁を目指す**



ルネサス エレクトロニクス株式会社

© 2010 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.